2027年3月期　中間期

決算説明資料

2026年11月13日

内外テック株式会社

（証券コード 3374）

2027年3月期　中間期

決算ハイライト

本日のポイント

POINT 1

2027年3月期　中間期実績

ＡＩ関連分野への設備投資が引き続き堅調に推移。受注増加により大幅な増収増益を達成

売上高 **24,658百万円**（前年同期比61.8%増）

営業利益 **1,251百万円**（前年同期比2.6倍）

親会社株主に帰属する中間純利益 **814百万円**（前年同期比2.6倍）

POINT 2

2027年3月期予想（上方修正）

半導体市場の活況を背景に、通期予想を上方修正。売上・利益ともに過去最高を見込む

売上高 **52,100百万円**（前期比59.7%増）

営業利益 **2,660百万円**（前期比89.6%増）

親会社株主に帰属する当期純利益 **1,780百万円**（前期比83.2%増）

POINT 3

中期経営計画「MIRAI 2030」を推進

成長戦略の一環として、「Taravine Partners１号投資事業有限責任組合」へ出資。
事業領域の拡大のほか、フィジカルＡＩ戦略のキーデバイスとなるセンサー技術や
ＡＩ／ＳＣＭシステム戦略における周辺要素技術力の強化を図る。

2027年3月期　中間期

連結業績・事業概況

2027年3月期 中間期 業績 （2026年4月～2026年9月）

・ＡＩ関連分野の半導体の旺盛な需要を背景とした設備投資が引き続き堅調に推移。
受注増加により、大幅な増収増益を達成

決算実績

（百万円）	2026.3期 上期			2027.3期 上期			
	実績	前年同期比	構成比	実績	前年同期比	構成比	8月7日開示予想
売上高	15,240	5.7%減	100.0	**24,658**	**61.8%増**	**100.0**	**24,500**
売上原価	13,299	6.5%減	87.3	**21,620**	**62.6%増**	**87.7**	**—**
販管費	1,453	3.8%減	9.5	**1,786**	**22.9%増**	**7.2**	**—**
営業利益	487	15.2%増	3.2	**1,251**	**2.6倍**	**5.1**	**1,185**
経常利益	478	18.7%増	3.1	**1,260**	**2.6倍**	**5.1**	**1,178**
親会社株主に帰属する中間純利益	310	22.8%増	2.0	**814**	**2.6倍**	**3.3**	**747**

売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

- 売上は半期ベースにおいて過去最高を更新
- 増収により大幅な増益を達成

売上高

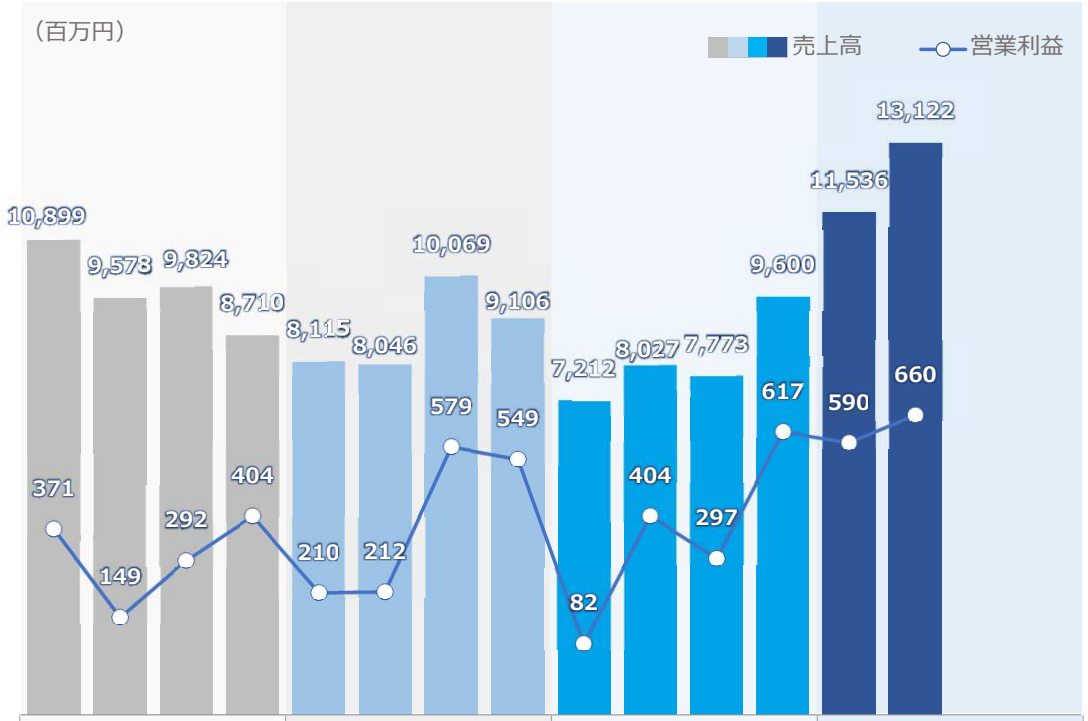
24,658百万円（前年同期比+61.8%）

- 半導体市場の活況を背景とした旺盛な設備投資需要により受注が拡大し、売上高は堅調に増加

営業利益

1,251百万円　（前年同期比 2.6倍）

- 販管費は増加するも、それを上回る増収効果により営業利益は2.6倍に



（百万円）	2024年3月期 上期	2024年3月期 下期	2025年3月期 上期	2025年3月期 下期	2026年3月期 上期	2026年3月期 下期	2027年3月期 上期	2027年3月期 下期
売上高	20,478	18,535	16,161	19,175	15,240	17,374	24,658	–
営業利益	521	696	423	1,128	487	915	1,251	–

売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

- 売上総利益率は、受託製造事業における人材などの先行投資により微減
- 販管費比率は、増収効果により大きく改善

売上総利益率

12.3%　（前年同期比▲0.4ポイント）

- 今後の増産及び成長に向けた人材投資により売上原価が増加し、売上総利益率は低下

販売管理費

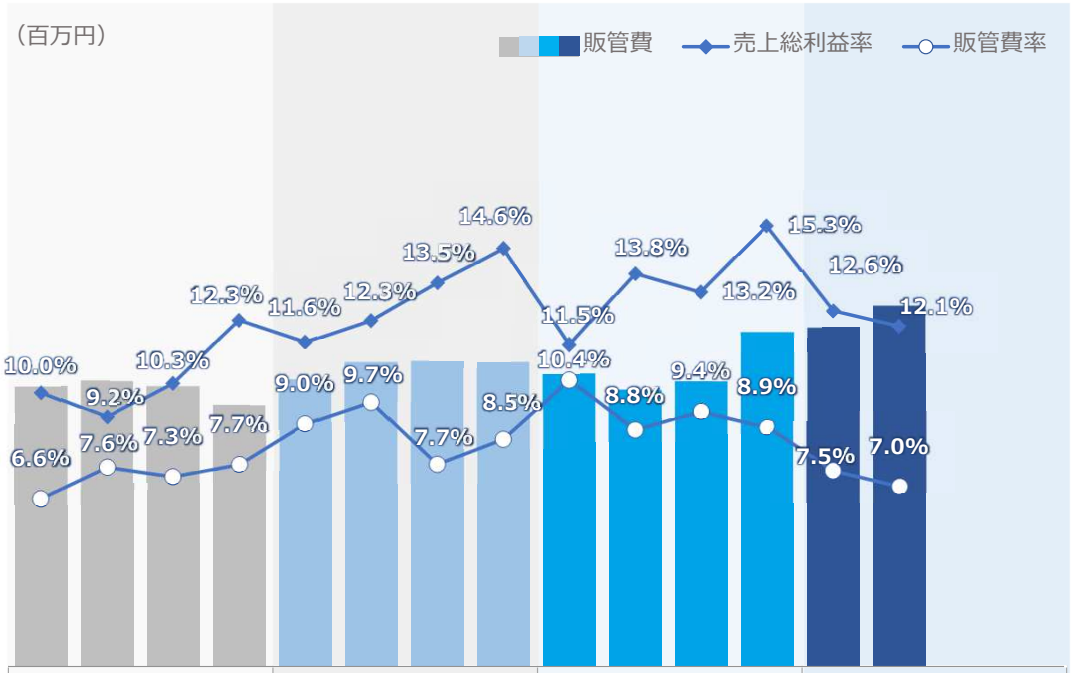
1,786百万円　（前年同期比+22.9%）

- 今後の成長のための人材投資・拠点拡大による地代家賃等の影響により増加

販売管理費率

7.2%　（前年同期比▲2.3ポイント）

- 販売管理費は増加をするも、それを上回る増収により販管費率は改善



（百万円）	1Q 2Q 3Q 4Q 2024年3月期 上期	下期	1Q 2Q 3Q 4Q 2025年3月期 上期	下期	1Q 2Q 3Q 4Q 2026年3月期 上期	下期	1Q 2Q 3Q 4Q 2027年3月期 上期	下期
売上総利益率	9.6%	11.2%	12.0%	14.0%	12.7%	14.4%	12.3%	–
販管費	1,446	1,383	1,510	1,558	1,453	1,584	1,786	–
販管費率	7.1%	7.5%	9.3%	8.1%	9.5%	9.1%	7.2%	–

セグメント別概況 販売事業

・半導体市場の活況を背景とした旺盛な需要が継続し前期からの増収傾向を継続

セグメント売上高

21,981百万円（前年同期比+65.7%）

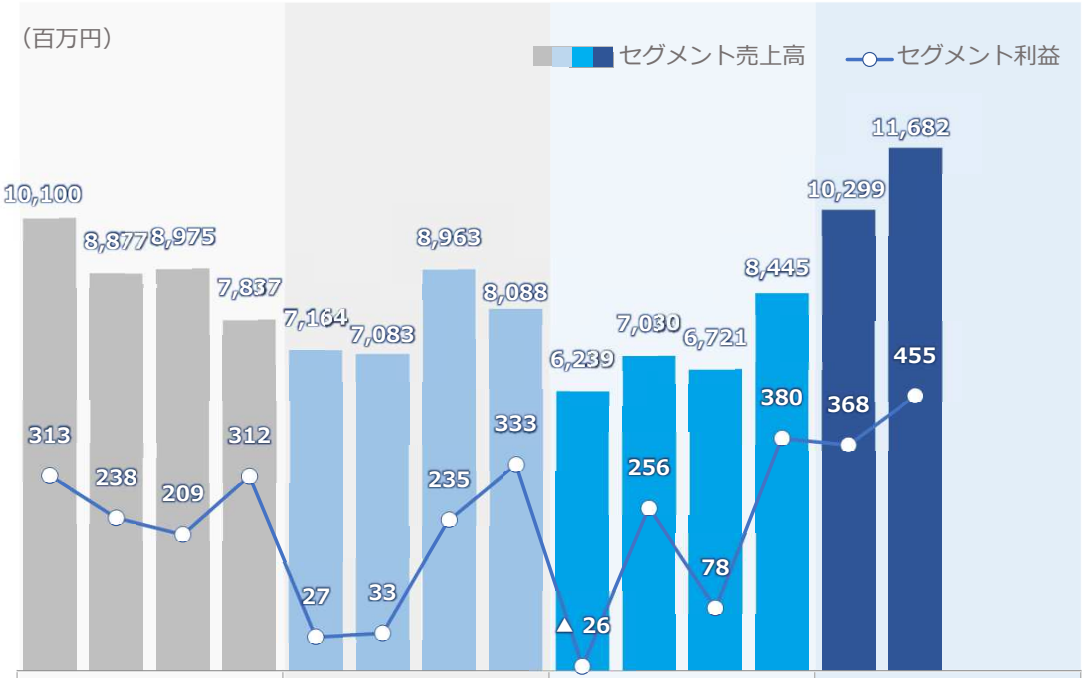
- 半導体市場の活況を背景に顧客からの受注が増加し大幅な増収を継続

セグメント利益

824百万円　（前年同期比 3.6倍）

- 今後の成長に必要な人材投資や体制強化等により費用が増加するも、増収によりセグメント利益は3.6倍に

（注）セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております



（百万円）	2024年3月期 上期	2024年3月期 下期	2025年3月期 上期	2025年3月期 下期	2026年3月期 上期	2026年3月期 下期	2027年3月期 上期	2027年3月期 下期
セグメント売上高	18,978	16,812	14,248	17,052	13,269	15,166	21,981	–
セグメント利益	551	521	61	569	230	459	824	–
セグメント利益率	2.9%	3.1%	0.4%	3.3%	1.7%	3.0%	3.7%	–

セグメント別概況 受託製造事業

・前期から増収傾向を継続。
増産に向けた生産能力の拡充・人員確保などの先行投資により、前下期比では減益

セグメント売上高

4,221百万円　（前年同期比+40.0%）

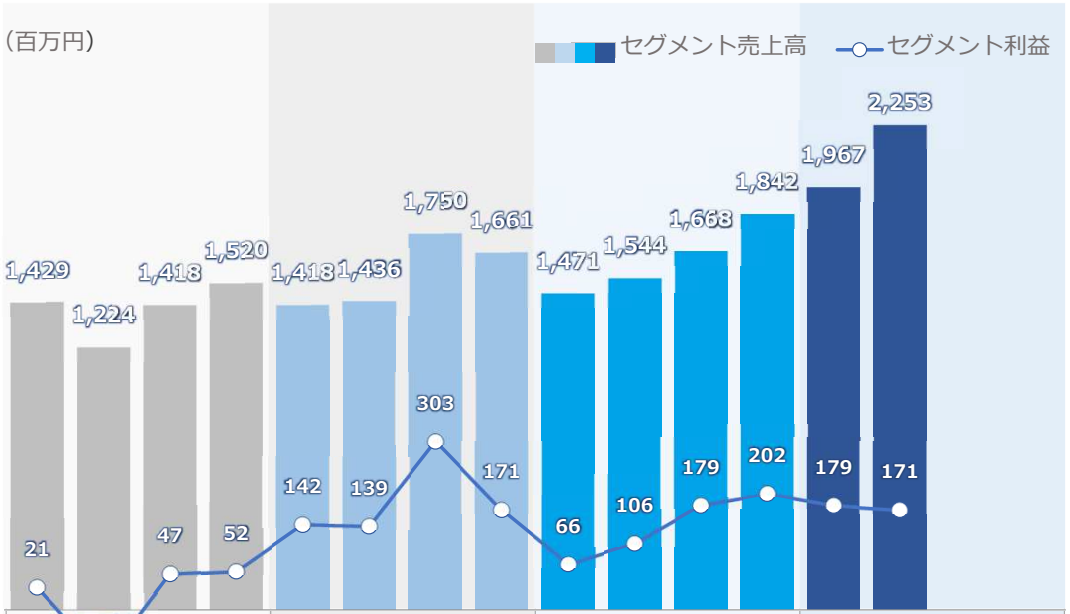
- 前期からの生産キャパの拡大により、受注増に効果的に対応

セグメント利益

350百万円　（前年同期比 2.0倍）

- 生産キャパの拡大により、費用増となるも
セグメント利益は２倍に

（注）セグメント売上高及びセグメント利益は、
連結調整前の数値となっております

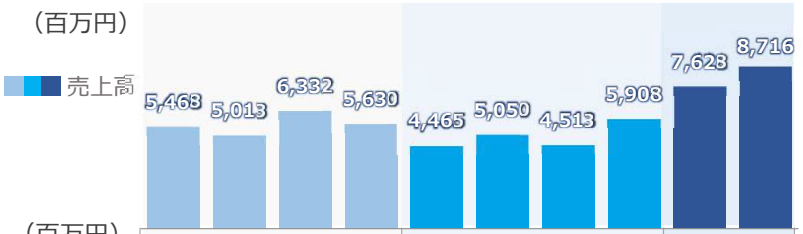


（百万円）	2024年3月期 上期	2024年3月期 下期	2025年3月期 上期	2025年3月期 下期	2026年3月期 上期	2026年3月期 下期	2027年3月期 上期	2027年3月期 下期
セグメント売上高	2,653	2,939	2,855	3,412	3,016	3,510	4,221	–
セグメント利益	▲101	99	281	474	173	381	350	–
セグメント利益率	–	3.4%	9.9%	13.9%	5.7%	10.9%	8.3%	–

事業ポートフォリオ別概況

サプライチェーン・ソリューション事業

- 主要顧客からの受注増加により堅調に推移

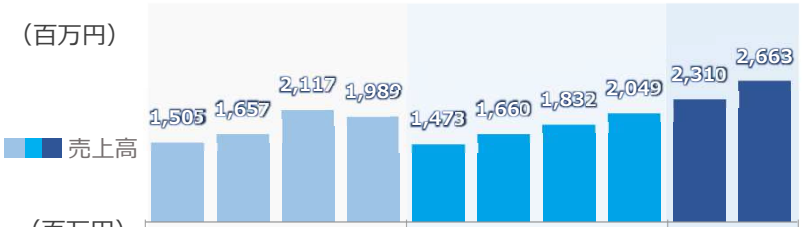


（百万円）

	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
	2025.3期				2026.3期				2027.3期	
	上期		下期		上期		下期		上期	
売上高	10,482		11,963		9,516		10,421		16,344	

マニュファクチャリング・ソリューション事業

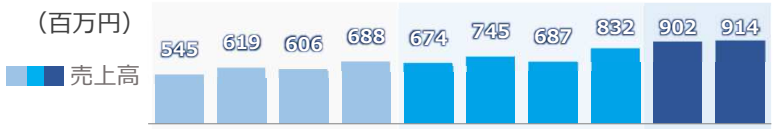
- 主要顧客からの受注増加により堅調に推移



（百万円）

	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
	2025.3期				2026.3期				2027.3期	
	上期		下期		上期		下期		上期	
売上高	3,163		4,106		3,133		3,881		4,973	

フィールド・ソリューション事業

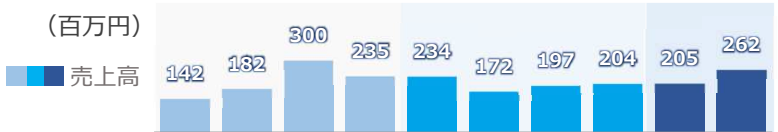


（百万円）

	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
	2025.3期				2026.3期				2027.3期	
	上期		下期		上期		下期		上期	
売上高	1,165		1,294		1,419		1,520		1,816	

- フィールドエンジニア増強戦略による増員が寄与し増収

テクニカル・ソリューション事業

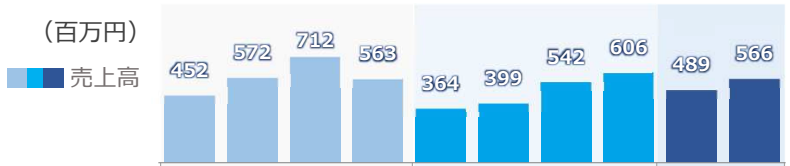


（百万円）

	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
	2025.3期				2026.3期				2027.3期	
	上期		下期		上期		下期		上期	
売上高	324		535		406		401		467	

- 設計・開発案件などを始めとした案件の増加により、前年同期比増収

プレシジョンマシニング・ソリューション事業



（百万円）

	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
	2025.3期				2026.3期				2027.3期	
	上期		下期		上期		下期		上期	
売上高	1,025		1,275		764		1,148		1,055	

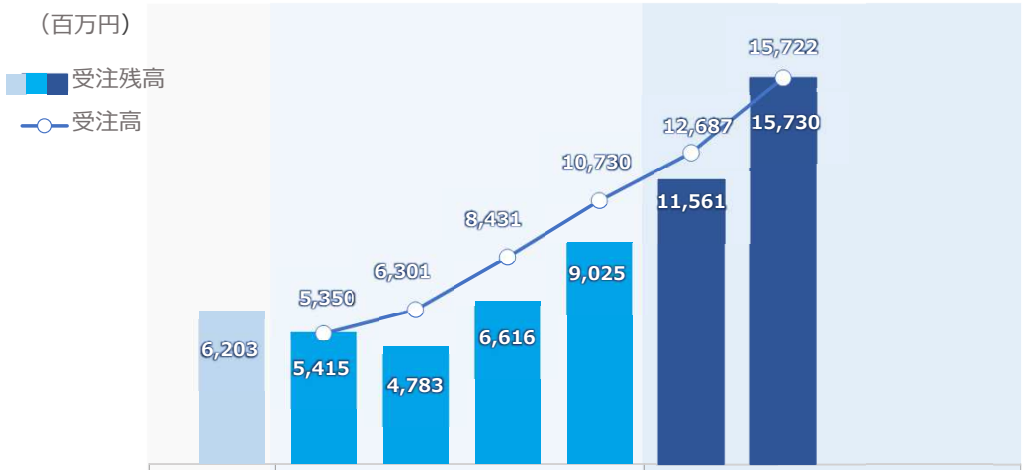
- 主要顧客からの受注増加により、前年同期比増収

受注高・受注残高の推移

- 販売事業・受託製造事業ともに受注高が堅調に推移し、受注残高は161億円と高水準に
- 豊富な受注残高が、下期以降の売上拡大を下支え

販売事業

受注残高　15,730百万円
（前期末比+74.3%）



（百万円）	2025年3月期	2026年3月期				2027年3月期			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
	通期	上期		下期		上期		下期	
受注高	25,436	11,651		19,161		28,409		–	
受注残高	6,203	4,783		9,025		15,730		–	

受託製造事業

受注残高　415百万円
（前期末比+50.5%）



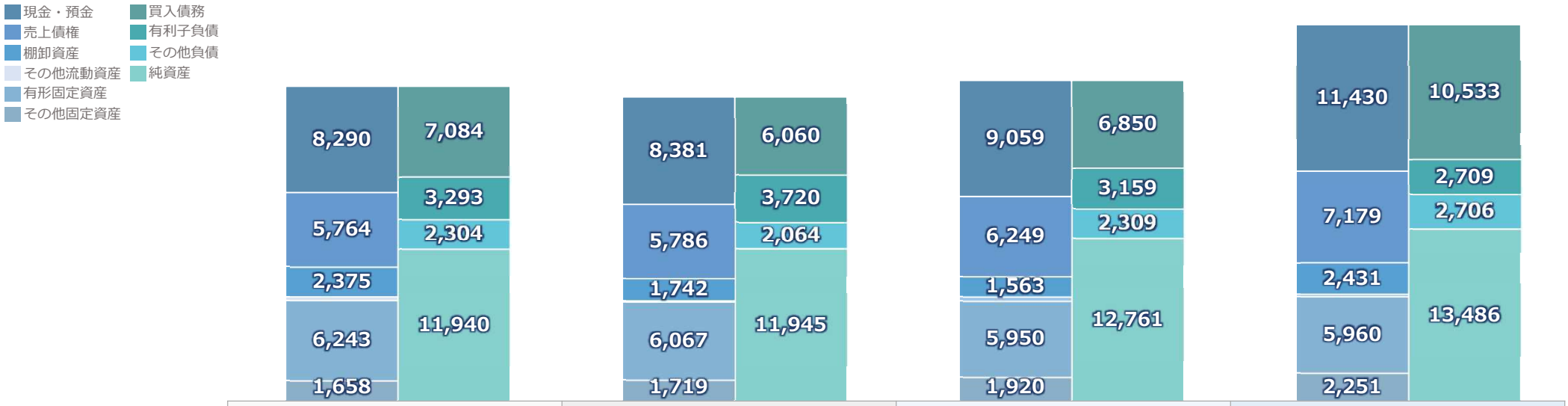
（百万円）	2025年3月期	2026年3月期				2027年3月期			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
	通期	上期		下期		上期		下期	
受注高	4,393	2,181		2,484		3,094		–	
受注残高	233	247		276		415		–	

連結貸借対照表

- 増収に伴い営業活動が拡大し、現預金・売上債権・買入債務が増加
- 棚卸資産は、堅調な受注に対応するための在庫確保により増加
- 自己資本比率は、買入債務の増加により前期末の50.9%から45.8%に低下

連結貸借対照表

（百万円）



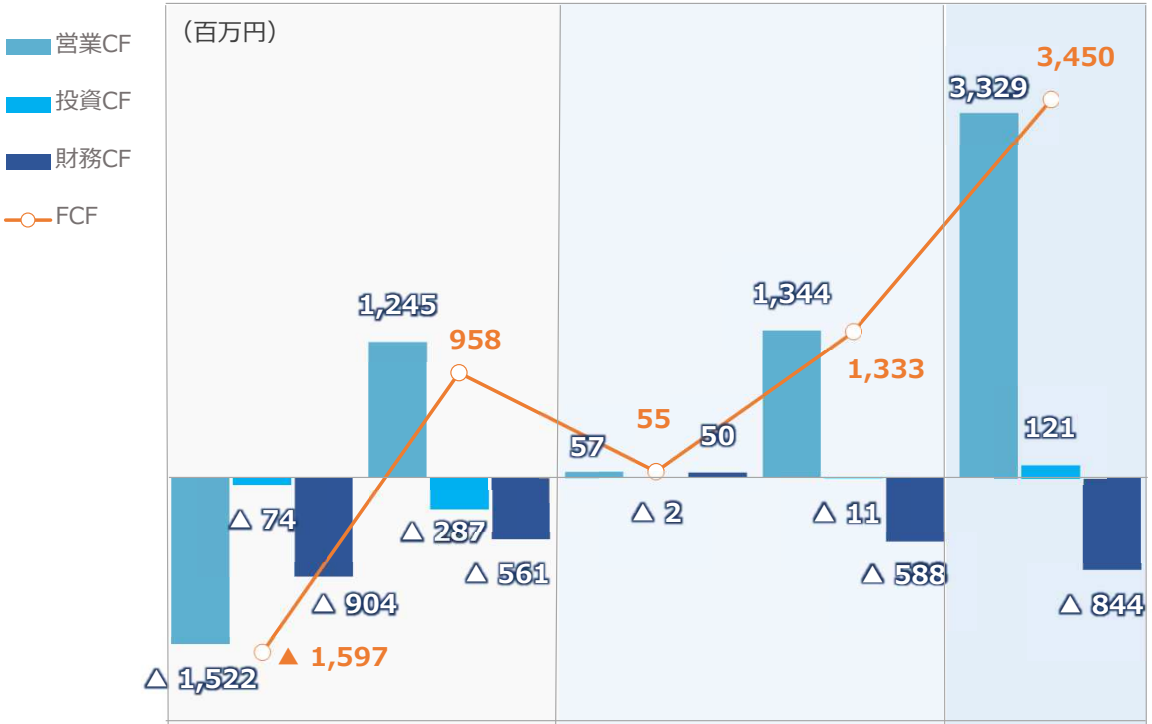
（百万円）	2025年3月末	2025年9月末	2026年3月末	2026年9月末
純資産	11,940	11,945	12,761	13,486
自己資本比率	48.5%	50.2%	50.9%	45.8%

連結キャッシュフロー

・営業キャッシュフローの大幅な黒字により、現金・現金同等物期末残高は112億円に拡大

キャッシュフロー計算書

- 営業キャッシュフローは、利益の獲得に加え、仕入債務の増加により大幅な黒字。売上債権・棚卸資産の増加による資金負担を吸収。
- 今後の成長・増産対応に向けた、仙台開発センター研究棟や物流拠点の整備等に投資を実施。定期預金の払戻がこれを上回り、投資キャッシュフローはプラス
- 長期借入金の返済・配当金の支払等により、財務キャッシュフローはマイナス



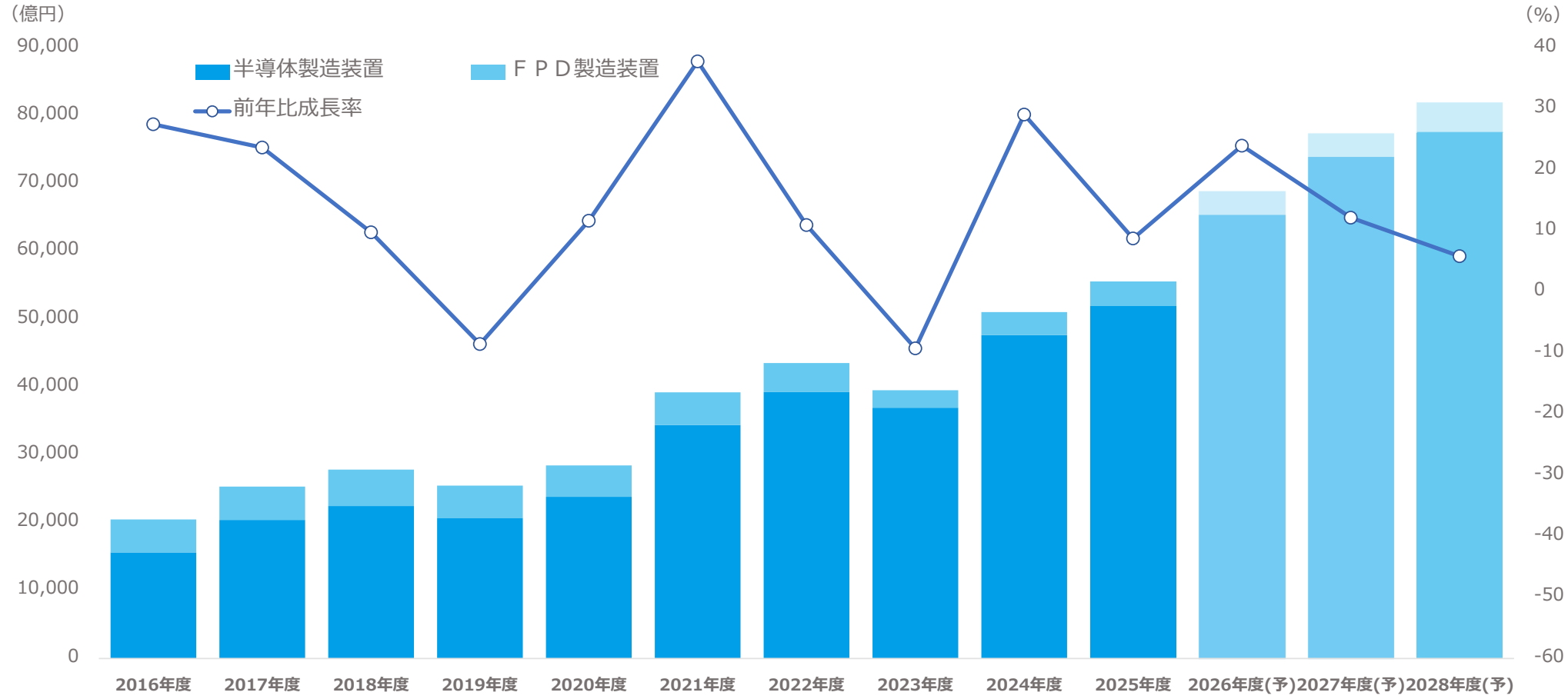
（百万円）	2025年3月期 上期	2025年3月期 下期	2026年3月期 上期	2026年3月期 下期	2027年3月期 上期
現金・現金同等物期末残高	7,361	7,756	7,860	8,609	11,217

2027年3月期
連結業績予想

半導体製造装置市場動向

・ＡＩ関連半導体の需要が市場を牽引し、中長期的に力強い成長が継続する見通し

半導体・FPD装置　日本製装置販売高予想



出所：SEAJ　2026年7月2日発表資料を基に当社にて作成

2027年3月期 通期連結業績予想（上方修正）

- ＡＩ関連を中心とした需要拡大と受注残高の積み上がりを背景に、大幅な増収を見込む
- 原材料価格や人件費の上昇圧力のほか、今後の増産対応や中期経営計画に基づく成長投資により費用は増加を見込むも、増収効果により増益を見込む

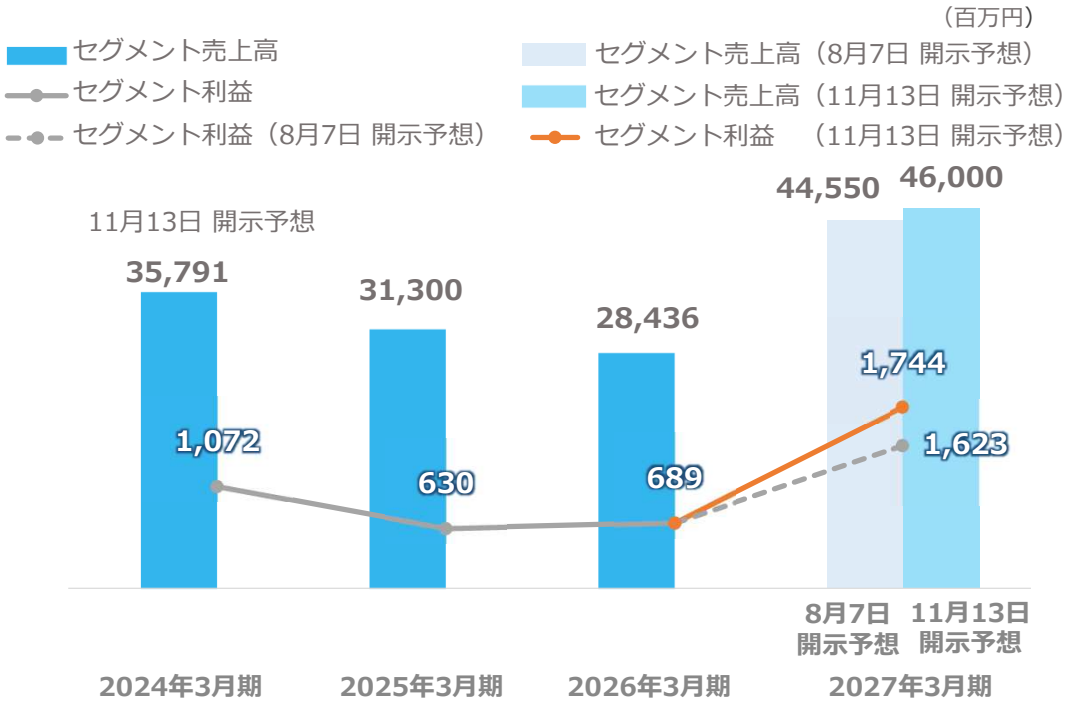
（百万円）	2026年3月期 通期 実績	2026年3月期 通期 前期比	2026年3月期 通期 構成比	2027年3月期 通期 通期予想	2027年3月期 通期 前期比	2027年3月期 通期 構成比	2027年3月期 通期 8月7日開示予想	2027年3月期 中間 中間実績	2027年3月期 中間 中間進捗率
売上高	32,614	▲7.7%	100.0	**52,100**	**59.7%**	**100.0**	50,900	**24,658**	**47.3%**
営業利益	1,402	▲9.6%	4.3	**2,660**	**89.6%**	**5.1**	2,560	**1,251**	**47.1%**
経常利益	1,389	▲9.0%	4.3	**2,650**	**90.8%**	**5.1**	2,540	**1,260**	**47.6%**
親会社株主に帰属する当期純利益	971	▲7.4%	3.0	**1,780**	**83.2%**	**3.4**	1,680	**814**	**45.8%**
1株当たり配当金	52.5円	―	―	**77.0円**	**―**	**―**	72.0円	**―**	**―**

※１株当たり配当金は株式分割（2026年12月1日を効力発生日、1株→2株）を遡及修正して表示しております。

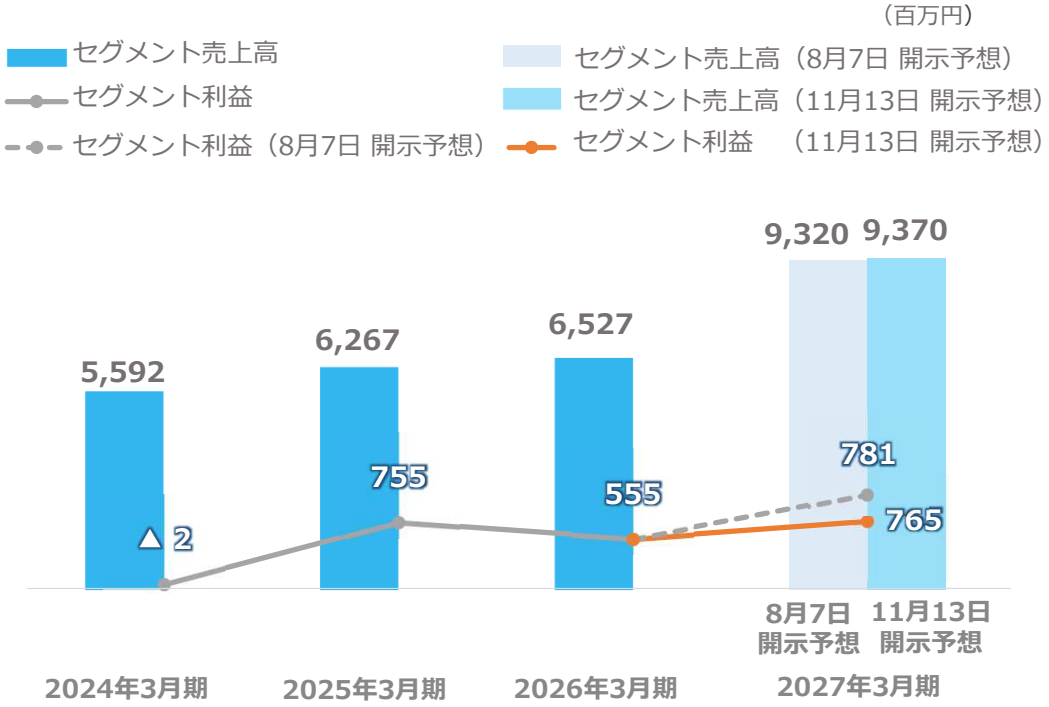
セグメント別業績予想（上方修正）

- 半導体市場の活況を背景に、販売事業・受託製造事業ともに堅調に推移
- 販売事業は、堅調な受注を背景に大幅な増収増益を見込む
- 受託製造事業は、増収を見込むも、キャパシティ確保及び更なる増産に向けた人員獲得により増益幅は限定的

販売事業



受託製造事業

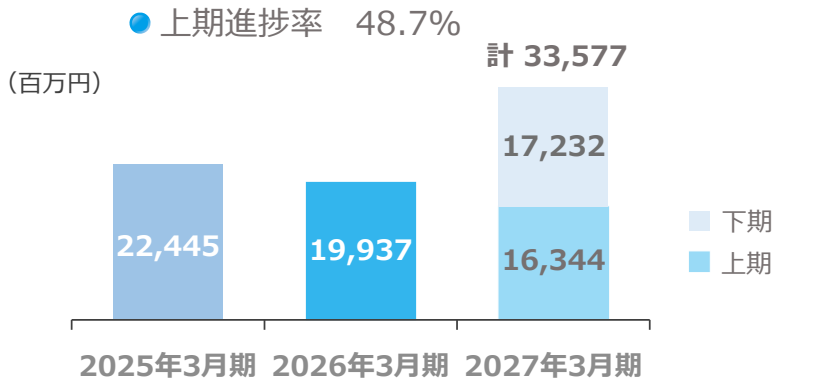


（注）セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております

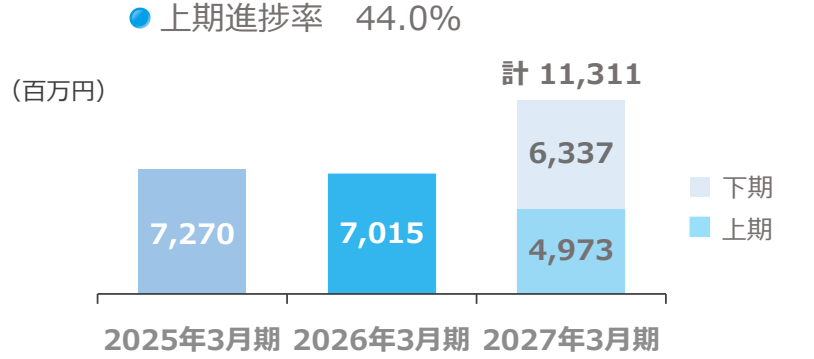
事業ポートフォリオ別業績予想

・下期も堅調な推移を見込み、全社業績予想・各事業ポートフォリオともに売上予想を上方修正

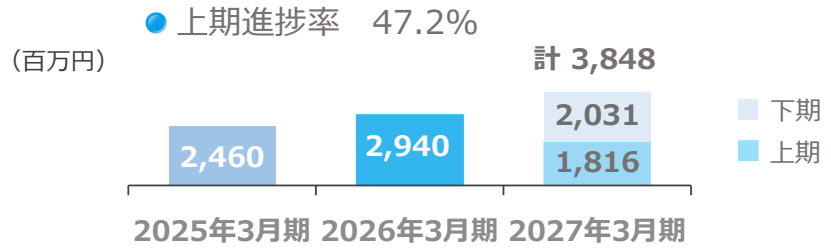
サプライチェーン・ソリューション事業



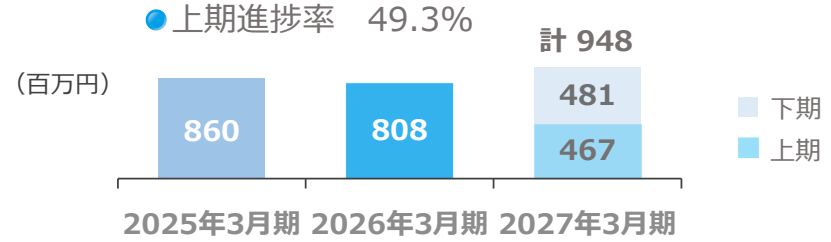
マニュファクチャリング・ソリューション事業



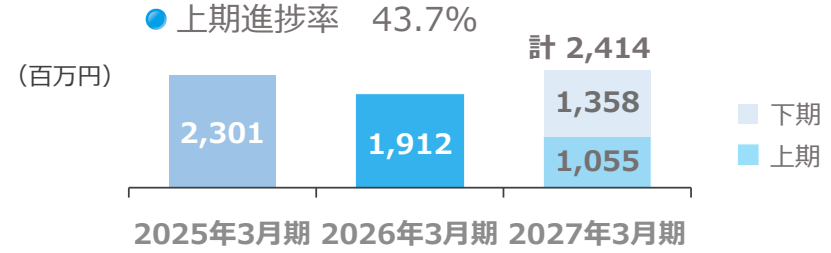
フィールド・ソリューション事業



テクニカル・ソリューション事業



プレシジョンマシニング・ソリューション事業



配当政策

- 投資しやすい環境整備と流動性向上を目的に、2026年12月1日付で1株→2株の株式分割を実施
- 業績好調を受け、配当予想を77円（株式分割前換算154円）へ増配を見込む

基本方針

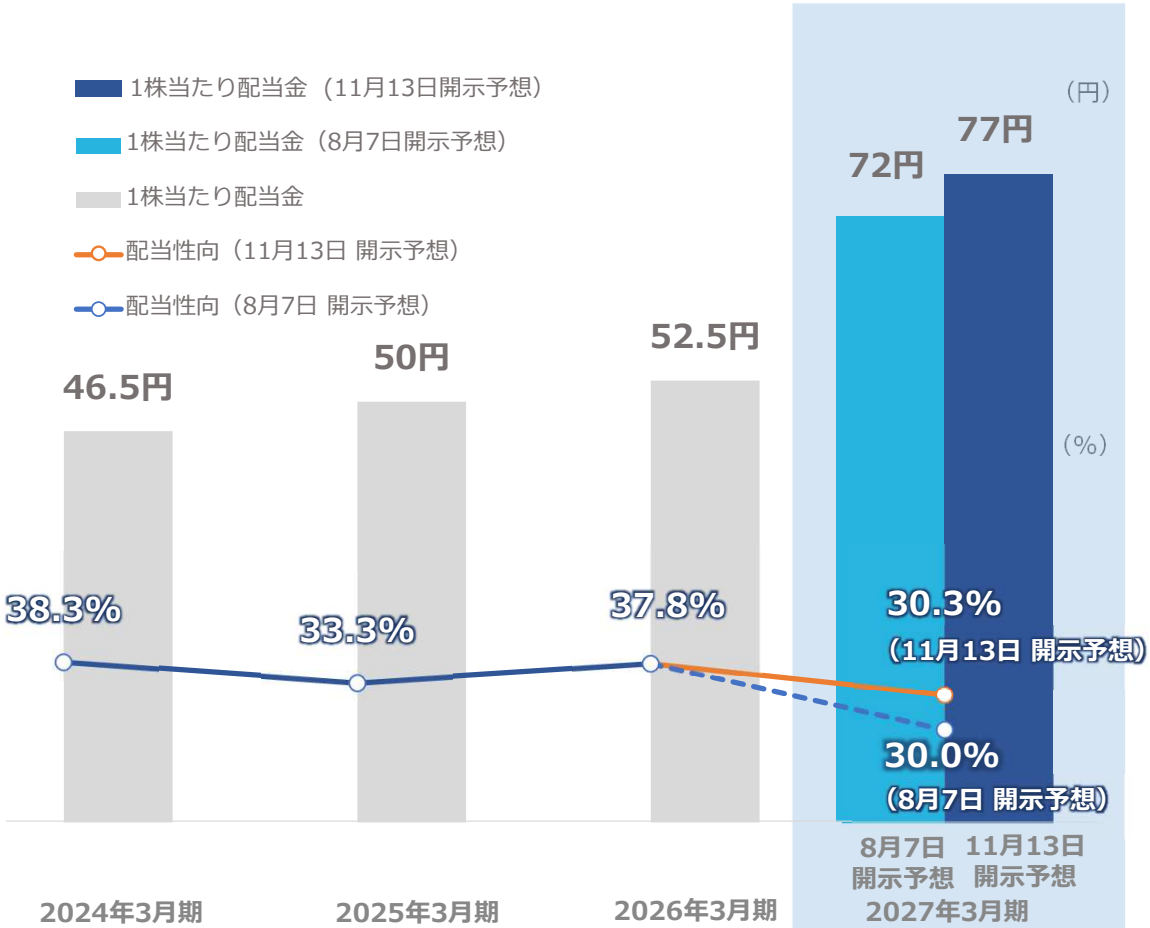
連結配当性向	30%以上
連結株主資本配当率（DOE）	3%以上

業績に応じた配当を継続していく

＊2024年2月13日配当方針の変更

株主還元に係る当社の考え方

- 中長期的な視点を持って継続的な企業価値向上により株主様へ還元してまいります
- 今後のさらなる半導体市場の成長を確実にキャッチアップするため、新しい事業領域を含めたＭ＆Ａをはじめ、工場の新設等、今後も積極的に投資を行っていきたいと考えております



※１株当たり配当金は株式分割（2026年12月1日を効力発生日、1株→2株）を遡及修正して表示しております。

中期経営計画

MIRAI 2030進捗

MIRAI 2030進捗　基本戦略（MIRAI 2026 継続）

1．技術開発強化

Taravine Partners 1 号投資事業有限責任組合 へ出資

・MIRAI 2030の成長投資として、半導体特化VCファンドへ出資
・有望な半導体スタートアップとの協業を通じ、事業領域の拡大を図る
・センサー技術やAI／SCM周辺技術を強化し、成長戦略の早期達成を目指す

仙台開発センターの研究棟新設

・電源工事完了
・2026年11月操業開始

2．フィジカルAI戦略

フィジカルAI

・フィジカルAIの開発・試験環境づくりに向け、AI技術を持つパートナー企業との連携を推進
　シミュレーション、AI、FA技術等を活用し、フィジカルAIの検証を加速

AI予知保全

・AI予知保全システムの試験運用を開始。さらなる予兆検知の精度の向上を目指し、
　パートナー企業との協議を開始

MIRAI 2030進捗　基本戦略（MIRAI 2026 継続）

3．AI人財育成

エンジニア教育

・XR技術のパートナー企業と、XRによるトレーニングコンテンツ作成を推進

AI活用人材教育

・AI活用人材の育成に向け、社員の外部資格取得を支援する教育コンテンツの拡充開始

4．株主還元方針

株式分割の決議

・投資家層拡大へ1株を2株に分割（11月30日基準、12月1日効力発生）
・定款変更により、発行可能株式総数を850万株から1,700万株に拡大
・投資単位を引き下げ、個人投資家をはじめ幅広い投資家が株式を購入しやすい環境を整備

5．従業員のエンゲージメント向上

新人事制度へ移行

・評価・処遇体系を含む人事制度の見直しを行い、新人事制度へ移行を実施
　従業員満足度・意欲・成長実感を高め、従業員のエンゲージメント向上を目指す

参考資料

参考資料 会社概要

本社所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、 受託製造が2本柱
従業員数	連結　779名（2026年9月末）
連結子会社	内外エレクトロニクス株式会社 株式会社OMT 納宜伽義機材（上海）商貿有限公司


本社・東京営業所

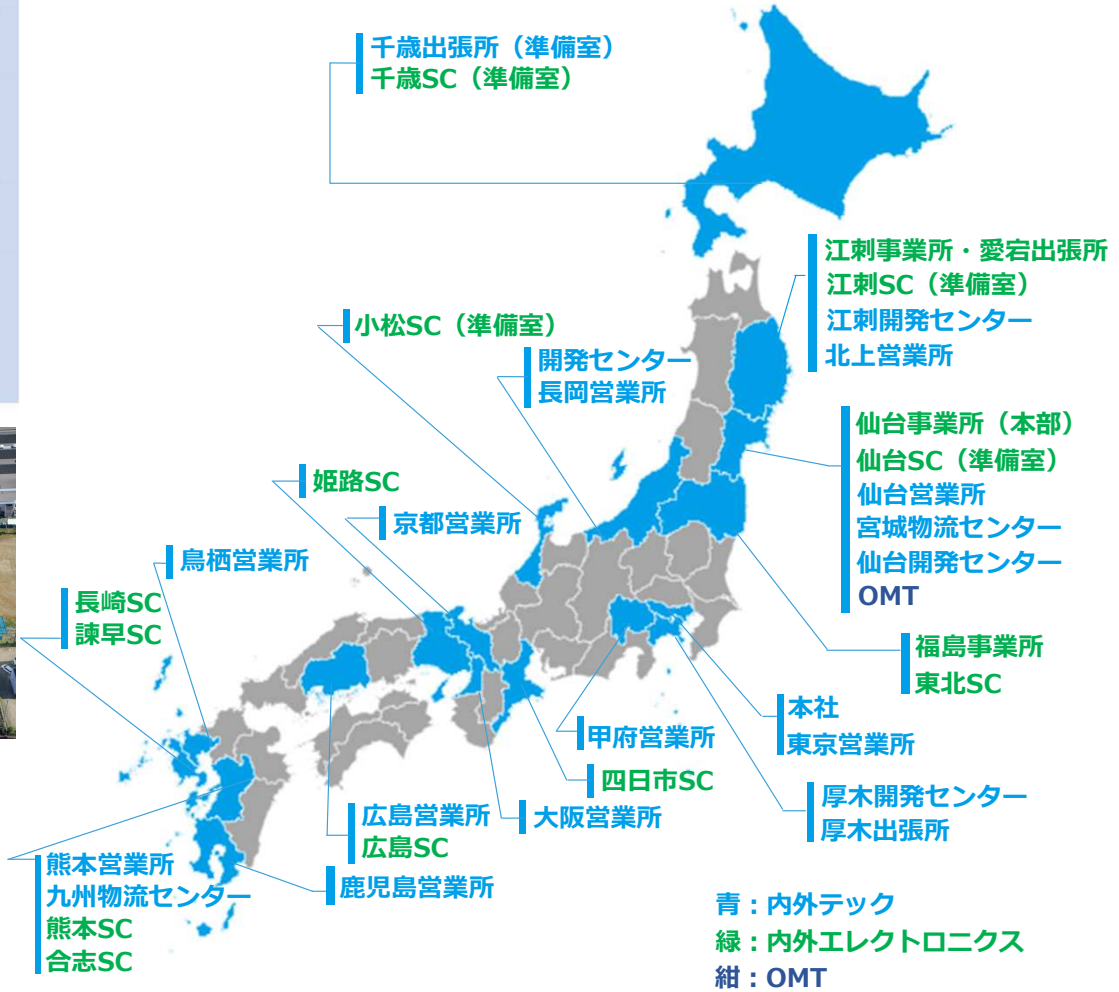

納宜伽義機材（上海）
商貿有限公司


仙台事業所

国内**38**拠点

海外**2**拠点

- 内外テック**20**拠点
- 内外エレクトロニクス**17**拠点
- OMT**1**拠点
- 内外機材(上海)**2**拠点



参考資料 当社グループの主力ビジネス

半導体製造工程概要



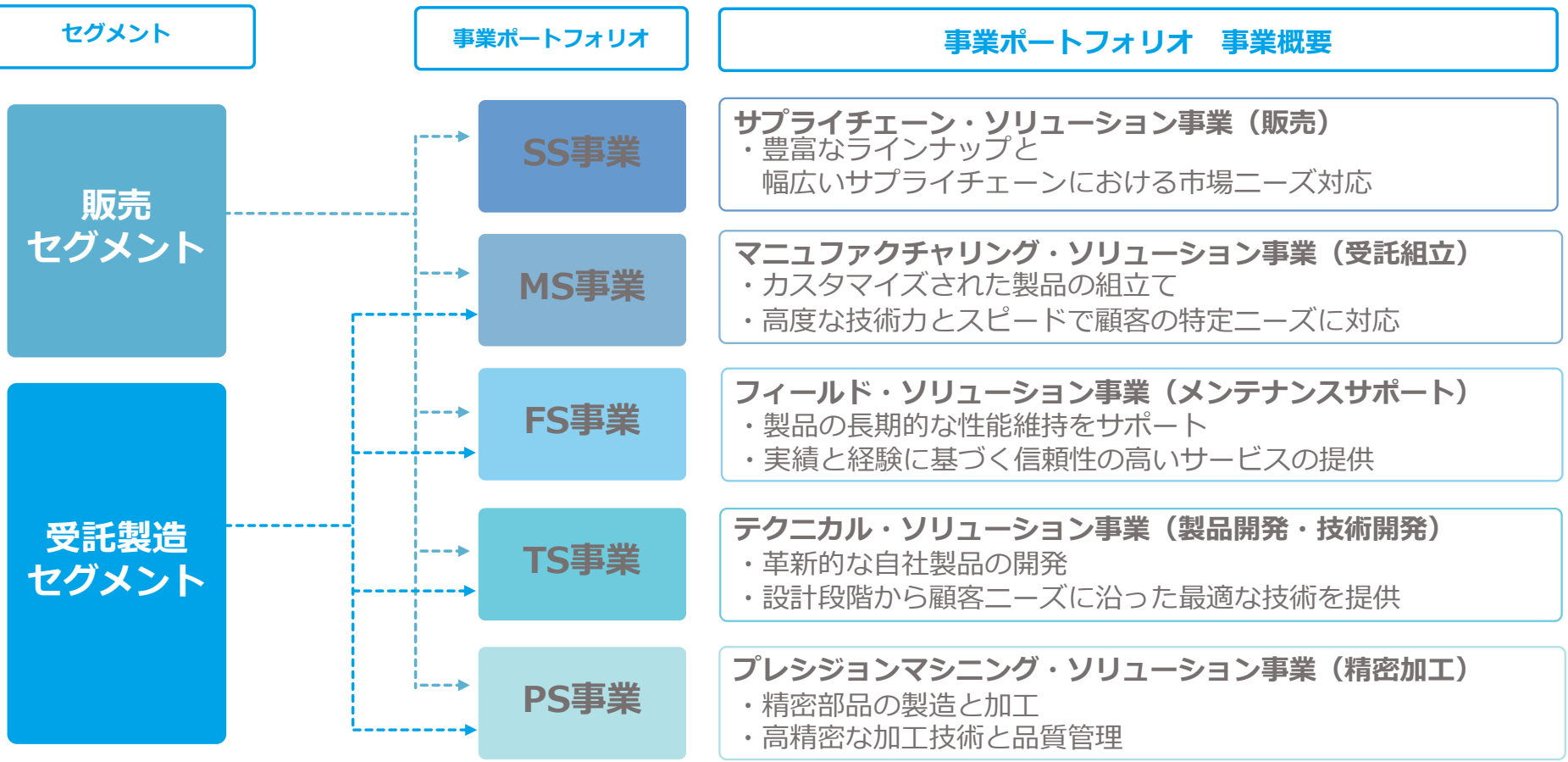
内外テック
技術提案商社
＋
内外エレクトロニクス
受託製造メーカー
＋
OMT
半導体製造設備
メンテナンス

モノづくりができるメーカー商社

事業ポートフォリオ概要

・資本の最適配分を目指し、事業ポートフォリオ管理を実施

事業ポートフォリオの概要



NaigaiTEC Corporation

・本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、
投資勧誘を目的としたものではありません
・本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、
当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、
その実現・達成を保証、約束するものではなく、
また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません
・銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします

内外テック株式会社

https://www.naigaitec.co.jp

スタンダード：3374